

第 32 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:令和 3 年 3 月 8 日(月) 13:30~16:30

オンライン開催

時 間	題 目	講 演 者
	司会 岩田 剛治 (大阪大学)	
13:30~ 14:10	『誘電エラストマーを用いた トランスデューサーとロボット』 (40分)	○新竹 純 (電気通信大学)
14:10~ 14:40	『はんだ材の線形粘弾性定式化による 接合部寿命解析の高速化』 (30分)	○矢尾板 明子 (㈱東芝)
14:40~ 15:00	休 憩	
	司会 山部 光治 (㈱東芝)	
15:00~ 15:40	『マイクロ波磁場加熱による はんだ実装』 (40分)	○金澤 賢司 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所)
15:40~ 16:20	『銅ナノペーストと Injection Molded Solder 法によるめっきフリーバンプ形成技術』 (40分)	○青木 豊広 (日本アイ・ビー・エム ㈱)
16:20~ 16:30	委 員 会 議 事	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。